超低背積層セラミックコンデンサ
Ultra Low Profile Type Multilayer Ceramic Chip Capacitor

IT-08

基板に内蔵することでセットの薄型化を実現

特 長

- 製品厚さ寸法:0.15mm max.
- 薄さと平坦化を可能とするCu端子電極

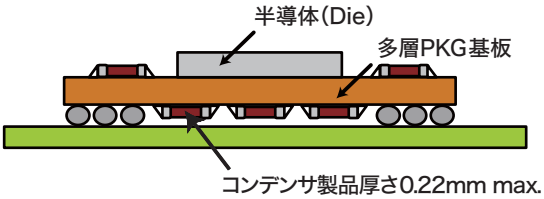
用 途

- 小型･薄型･高密度実装基板への埋め込み
- IC直下のデカップリングコンデンサ

特 性

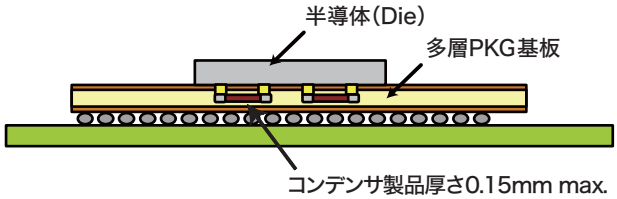
従来製品　厚さ:0.22mm max. の使用例

BGAの裏側に実装

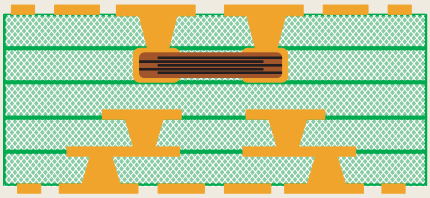


開発製品　厚さ:0.15mm max. の使用例

基板の中に埋め込み化



想定される埋め込み方式

実装方式	構造図	接合工法	接合	求められる端子構造
ビア接続方式	 部品内蔵後に内蔵部品の端子上にビアを形成して接続する方式	ビア接続	Cuめっき	Cuめっき 端子平面部の平坦性 (片面電極)

お問い合わせ先：セラミックコンデンサビジネスグループ　営業推進統括部 tel:03-5201-7226